

# tesa® HAF 8412

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



conductive HAF เทป สีเหลืองอำพัน 45 ไมครอน

### รายละเอียดสินค้า

tesa® HAF 8412 เป็นฟิล์มกาวกระตุ้นด้วยความร้อน สีเหลืองอำพัน ประกอบด้วย phenolic resin และ nitrile rubber และมีอนุภาคที่เป็นสื่อไฟฟ้า

คุณสมบัติพิเศษ:

- การยึดติดโมดูลชิพและการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าในขั้นตอนเดียว
- สามารถใช้การได้ดีกับสายการผลิตฝังชิพทั่วไป
- เหมาะสำหรับการ์ด DI วัสดุ PVC, ABS, PET และ PC
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ

ความหนา: 45 µm (ค่ากลางของขนาดอนุภาค)

### สาขาการใช้งาน

tesa® HAF 8412 ออกแบบสำหรับ การฝังชิพโมดูลลงในสมาร์ตการ์ดชนิด dual interface

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	none	• ความหนารวม	50 µm
• ประเภทของกาว	nitrile rubber / phenolic resin	• สี	สีเหลืองอำพัน
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• ความต้านทานการสัมผัสแนวแกน Z	200 mOhm	• แรงยึดเกาะ (ผลึก)	3 N/mm <sup>2</sup>
• อุณหภูมิที่ทำให้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยา	120 °C		

### ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำทางเทคนิค:

ค่าต่างๆ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับพารามิเตอร์ของเครื่องมือที่จะใช้ในเบื้องต้น

โปรดทราบว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องจักร รวมทั้งวัสดุที่ใช้สำหรับตัวการ์ด ชิปโมดูลและข้อกำหนดของลูกค้า

#### 1. การเคลือบเบื้องต้น:

ช่วงการติดเคลือบเบื้องต้น เทปกาวได้รับการเคลือบบนสายพานโมดูล ขั้นตอนการเคลือบเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบต่ออายุของเทป สายพานโมดูลที่ได้รับการเคลือบติดเทปสามารถเก็บรักษาไว้ได้โดยใช้เวลาเท่ากับอายุการใช้งานของเทป

การตั้งค่าเครื่องจักร:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8412>

# tesa® HAF 8412

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

\*อุณหภูมิ 130 – 150 °C

\*แรงกดทับ 2 – 3 บาร์

\*ความเร็ว 1.5 – 2.5 ม./นาที

### 2. การฝังโมดูล:

ระหว่งการฝังโมดูล

โมดูลที่เคลือบจะถูกไต่จากสายพานโมดูลและถูกวางเข้าในช่องของบัตรและติดอย่างถาวรเข้ากับตัวบัตรโดยความร้อนและแรงกดทับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ implanting line สามารถใช้วิธีการกดทับขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนก็ได้

ปัจจุบันเครื่องฝังชิพส่วนใหญ่ใช้แรงกดด้วยความร้อนแบบหลายขั้นตอน

ขั้นตอนเดียว - การตั้งค่าเครื่อง:

\*อุณหภูมิ<sup>1</sup> 180 – 220 °C

\*แรงกดทับ 80 – 130 N/โมดูล

\*เวลา 1.5 วินาที

กระบวนการหลายขั้นตอน (การกดอัดด้วยความร้อน 2 ครั้งหรือมากกว่า) – การตั้งค่าเครื่อง:

\*อุณหภูมิ<sup>1</sup> 180 - 220 °C

\*แรงกดทับ 80 - 130 N/โมดูล

\*เวลา 2 x 0.7 s / 3 x 0.5 วินาที

<sup>1</sup>อุณหภูมิตามที่วัดได้ภายในเครื่องกดอัดด้วยความร้อน มีข้อเสนอแนะการตั้งค่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันสำหรับวัสดุบัตรที่แตกต่างกัน ดังนี้:

PVC 180 – 190 °C

ABS 180 – 190 °C

PET 190 – 200 °C

PC 200 – 220 °C

เพื่อการติดที่แข็งแรงสูงสุด พื้นผิวจะต้องสะอาดและแห้ง สภาวะการเก็บรักษาเป็นไปตามแนวทางอายุการเก็บรักษาของ tesa® HAF

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่างไรก็ดี เป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=8412>